

" The 1inside Edge that shapes the future "

디지털 시대의 핵심기술을 선도해 나가는 삼성전기에서
창의성과 역량을 갖춘 진취적 인재를 모시고자 합니다.

1. 부문

기계

Package 열유체, Micro Fluidics, 자동화 제어

압전구동형 Print Head의 구조와 해석분야

Package신뢰성 해석, 점소성 관련Simulation, Failure Analysis

Micro Actuator구조, MEMS Device, MEMS 공정

전자/전기/컴퓨터

화상검사 Algorithm 개발 (2D,3D 영상처리 컴퓨터 비전)

Device driver개발,Network Protocol,WinCE,Linux,Symbian

재료,화학,화공

고분자 재료, Bumping용 재료, 공정개발, Water Level Packaging

도금조건 최적화, 도금액 설계,도금층 분석,도금설비 검토 및 적용

도금공정 Parameter 해석, 동도금/전해도금 mechanism 안정화

2. 대상

- 해당분야 박사(Post Doc,포함)학위 취득예정자 또는 기 취득자.

3. 일정

※ Resume를 보내주시면 전공분야 검토 후, 미주 현지면접 또는 당사 초청면접 예정
e-mail로 제출 바랍니다.(recruit.sem@samsung.com)

- Resume제출: 상시지원가능

4. 문의

- 인사팀 채용G 김수봉 주임(recruit.sem@samsung.com / 82-31-210-6557)